PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-115870

(43) Date of publication of application: 16.04.1992

(51)Int.CI.

B24C 11/00

(21)Application number : **02-233324**

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing:

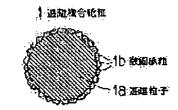
05.09.1990

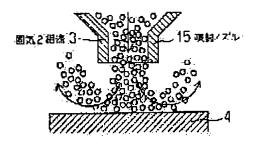
(72)Inventor: KURODA MASAYUKI

(54) INJECTION TYPE WORK DEVICE FOR FREE COMPOSITE ABRASIVE GRAIN (57)Abstract:

PURPOSE: To shorten the working time, the cleaning and drying time after work, namely to improve the working efficiency, with an easy arrangement, by using that which coats a lot of fine brasive grains on the surface of a free particle, as a free composite abrasive grain.

CONSTITUTION: The body which coats a lot of fine abrasive grains 1b on the surface of a free particle 1a is used as the free composite abrasive grain of the device made to perform the work with a free composite abrasive grain 1 and the solid gas 2 phase of a gaseous body being injected to the body 4 to be worked. Consequently, the works of the lap finishing that the surface roughness of the body 4 to be worked is improved, polishing, etc., can be facilitated.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

@ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-115870

Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成 4年(1992) 4月16日

B 24 C 11/00

Z 7604-3C

> 未請求 請求項の数 1 (全4頁) 審査請求

60発明の名称

遊離複合砥粒噴射式加工装置

願 平2-233324 201件

願 平2(1990)9月5日 29出

@発明者

黒 田

正 幸

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

勿出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

個代 理 人 弁理士 高橋 光男

1. 発明の名称

遊離複合砥粒噴射式加工装置

2. 特許請求の範囲

遊離複合砥粒と気体の固気2相流を被加工物に 噴射してその加工を行うようにした装置において、

前記遊離複合砥粒は遊離粒子の表面に多数の微 細砥粒を被覆してなる事を特徴とする遊離複合砥 粒噴射式加工装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、遊離複合砥粒噴射式加工装置に係り、 特に遊離複合砥粒と気体の固気2相流を被加工物 に噴射してその加工、即ちラップ仕上(lapping) やポリッシング(polishing)を行うようにした加 工装置に関する。

〔発明の概要〕

遊離粒子の表面に多数の微細砥粒を被覆した遊 離複合砥粒と高圧の気体とからなる固気2相流を 被加工物に噴射して、この被加工物を加工するよ うにした事により、加工効率を向上し、容易に鏡 面仕上げが可能な加工装置を提供する。

〔従来の技術〕

従来、ラップ仕上では、数μm~数10μmの粗 い砥粒を使い、工具として鋳鉄等の硬い金属が使 用されていたので、被加工物の加工面は光沢のな い梨地面になった。

ポリッシングでは、1μm以下の微細砥粒を使 い、ポリッシャとして軟質の工具を用いて、被加 工物の加工面を鏡面仕上げをしていた。

これらの従来のラップ仕上やポリッシングによ る加工では、その段取りが大変であり、加工時間 が掛かるという問題点があった。そして、その加 工後の洗浄や乾燥にも多くの時間を必要としてい た.

しかも、加工面の端面がダレる問題点があり、 曲面や非球面の加工が大変で、微細加工に適して いないという問題点があった。

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、従来のこのような問題点を解決する ためになされたものであって、

遊離粒子の表面に多数の微細砥粒を被覆した遊離複合砥粒と高圧の気体とからなる固気 2 相流を被加工物に噴射して、この被加工物を加工、即ち
ラップ仕上やポリッシングするようにした事によ
り、加工効率を向上し、容易に鏡面仕上げや微細
加工が可能な加工装置を提供する事を課題する。

〔課題を解決するための手段〕

本発明は、遊離複合砥粒と気体の固気 2 相流を 被加工物に噴射してその加工を行うようにした装 置、即ち遊離複合砥粒噴射式加工装置において、

前記遊離複合砥粒としては、遊離粒子の表面に 多数の微細砥粒を被覆したものを用いる。

遊離複合砥粒噴射式加工装置である。

この第1図において、11は遊離複合砥粒供給管、 12は高圧気体供給管、13は吸引ノズル、14は固気 2相混合管、そして、15は噴射ノズルを示す。

本発明の装置の特徴は、この装置に用いられる 遊離複合砥粒 1 が、第 2 図に示すように、遊離粒

〔作用〕

このような遊離複合砥粒と気体の固気 2 相流を被加工物に噴射してその加工を行うようにした装置の遊離複合砥粒として、遊離粒子の表面に多数の微細砥粒を被覆したものを用いる事により、

被加工物の表面粗さを向上したラップ仕上やポリッシング等の加工を容易にする事が出来る。

〔実施例〕

以下、本発明の遊離複合砥粒噴射式加工装置の一実施例を第1図乃至第3図を参照して説明する。第1図は本発明の遊離複合砥粒噴射式加工装置の断面図、第2図は第1図の装置に用いられる遊離複合砥粒の拡大断面図であり、そして第3図は第1図の噴射ノズルの部分拡大断面図である。

本発明の装置は、第1図に示すように、遊離複合砥粒1と高圧の気体2とからなる固気2相流3を被加工物4に噴射して、この被加工物4のラップ仕上やポリッシング等の加工をするようにした

子laの表面に多数の微細砥粒lbを被覆した砥粒からなる点にある。遊離粒子laは軟質材からなる。

即ち、遊離粒子laと微細砥粒lbは第1表のような材質と粒径のものを使用する。

第1表

	材質	粒径
遊離粒子	ナイロン	1 ~50 µ m
	スチレン等	
	A l 2 O 3	,
微細砥粒	ジルコニア	0.01~ 1 μ m
	Si ₂ N ₄	
	Sic	
	酸化チタン等	

第3図は第1図に示した噴射ノズルの部分拡大

断面図で、遊離複合砥粒1として、第1表に示したような、1~50μmの粒径の軟質材からなる遊離粒子1aの表面に0.01~1μmの粒径の微細砥粒1bを被覆させ、この遊離複合砥粒1と高圧の気体2の混合流である高速な固気2相流3(流速は100m/sec程度)を被加工物4に噴射し、この被加工物4のラップ仕上やボリッシング等の加工をする。ラップ仕上やボリッシング等の加工をする。ラップ仕上やボリッシング等の加工をする。ラップ仕上やボリッシング等の加工の後の被加工物4の表面粗さは、微細砥粒1bの粒径の1/10~1/100の鏡面仕上げが可能である。

微細砥粒1bの粒径の1/10~1/100の表面粗さに加工後の被加工物 4 の面がなる理由を説明する。

遊離粒子1aが例えばナイロン球で、その裏面に例えばSiCの微細砥粒1bが被覆され、遊離複合低粒1と高圧の気体2との混合流である固気2相流3が被加工物4に噴射され、被加工物4のラップ仕上やポリッシング等の加工をして鏡面仕上げが可能なのであるが、高圧の気体に微細砥粒1bのみが一粒、一粒ばらばらに、一様に分散化され、これらの微細砥粒

lbの 1 個、 1 個がそれぞれ別々に被加工物 4 に当たる場合、微細砥粒lbが細かすぎて速度エネルギーがないため、時間を掛ければ別であるが、微細砥粒lbの粒径程度の表面粗さを出すのがやっとであった。

遊離複合砥粒1が何回も、即ち遊離粒子1aに被 覆した微細砥粒1bが何回も被加工面4のある一定 の面に当たるのである。遊離複合砥粒1、即ち微 細砥粒1bの塊が大きな速度エネルギーを持って、 被加工物4に衝突する。従って、微細砥粒1bの粒 径の1/10~1/100の表面粗さの鏡面に被加工物4 を加工する事が出来る。しかも、固気2相流3の 流速は非常に高速なため、加工する速度が早い。 即ち加工の効率が良い。

遊離複合粒子1の粒径は、遊離粒子1a($1\sim50$ μ m)やその表面に被覆した微細砥粒1b($0.01\sim1$ μ m)の粒径から理解できるように非常に微細である。従って、この遊離複合粒子1を使った加工は、微細な加工に適している事はいうまでもない。

次に、第1図に戻り、装置のその他の部分を説明する。第1図において、21は回収フード、22は回収ジャバラ、23は回収タンク、そして、24は回収管である。非加工物4は、 X、 Y、 Z 軸方向に移動可能なワークテーブル25に取り付けられている。被加工物4に噴射された固気 2 相流 3 は回収フード21と回収ジャバラ22により外部に漏れる事なく、回収タンク23に集まり、回収管24を通り、図示していない送風機により、回収装置によって、遊離複合砥粒1が回収される。

遊離複合砥粒 1 は、遊離粒子laから微細砥粒1bが剝離していないので、何回も使用する事が可能である。

被加工物 4 に衝突した後の遊離複合砥粒 1 は、遊離粒子 1 a がナイロン等の軟質材であるので、流れの乱れが生ずる事なく回収タンク23の方へ流れでる。そのため、噴射ノズル15から噴射する固気 2 相流 3 と、被加工物 4 の面に衝突した流れとが互いに衝突する事を最小限度に防止出来るため、噴射ノズル15より噴射される間気 2 相流 3 の速度

エネルギーを最大限利用して、ラップ仕上やポリッシング等の加工をする事が出来る。

遊離粒子laがナイロン等の軟質材であるので、 更に一層、仕上げ面を鏡面にする事ができる。

しかも、従来の技術で説明したポリッシャとして軟質の工具を使用したものと異なり、端面がダレる問題が生じない。従って曲面や非球面の加工も容易である。

〔発明の効果〕

以上のように、本発明は、遊離複合砥粒と気体の固気 2 相流を被加工物に噴射してその加工を行うようにした装置、即ち遊離複合砥粒噴射式加工装置において、

遊離粒子の表面に多数の微細砥粒を被覆したものを遊離複合砥粒として用いる事により、

段取りが楽になり、加工時間や加工後の洗浄や 乾燥時間の短縮、即ち加工効率の向上が可能とな る。しかも、被加工物の表面粗さの向上、加工面 の端面のグレ防止、従って、曲面や非球面の加工 が可能な微細加工に適したラップ仕上やポリッシング等の加工をする事が出来る。

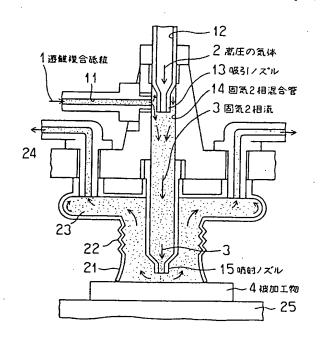
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の遊離複合砥粒噴射式加工装置の断面図、第2図は第1図の装置に用いられる遊離複合砥粒の拡大断面図であり、そして、第3図は第1図の噴射ノズルの部分拡大断面図である。

1 遊離複合砥粒
2 高圧の気体
3 間気 2 相渡
4 被加工物
13 吸引ノズル
14 間気 2 相混合管

15……・噴射ノズル

特許出願人 ソニー株式会社 代 理 人 弁理士 高橋光男

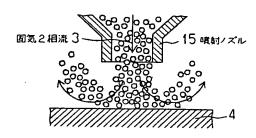


第1図 本発明の遊離複合砥粒噴射式加工装置 の断面図

1 遊離視合砥和

18 遊離粒子

第2図 第1図の装置に用いられる遊離複合紙 粒の拡大断面図



第3図 第1図の噴射ノズルの部分拡大図